**國家中山科學研究院飛彈火箭研究所**

**109年第三次人力進用招考甄試簡章**

**壹、員額需求：**

全時工作人員研發類65員，依「國家中山科學研究院飛彈火箭研究所109年第三次人力進用招考員額需求表」辦理(如附件1）。

**貳、薪資及待遇：**

一、薪資：依本院新進人員薪資核敘基準表之薪資範圍內，核給基本薪。

二、福利、待遇：

(一)享勞保、健保及依勞工退休金條例第14條按月提繳退休金。

(二)得依條件申請員工宿舍。

(三)年終工作獎金之發放，依本院訂頒之「年終工作獎金發放作業規定」及「員工工作規則」辦理。

(四)因任務需要超時工作，依本院「員工工作規則」辦理。

(五)詳細待遇及權利義務內容於本院「勞動契約」訂定之。

(六)軍公教退伍(休)轉任人員，薪資超過法令所訂基準(含主管加給、地域加給)，依法辦理。

(七)公務人員退休人員再任本院員工，依「公務人員退休資遣撫卹法及其施行細則」規定辦理。

(八)退休教職員再任本院員工，依「學校教職員退休條例及其施行細則」規定辦理。

**參、報考資格：**

1. 國籍：具中華民國國籍，並在臺灣、澎湖、金門、馬祖地區設有戶籍者。
2. 學、經歷：教育部評鑑合格之各大學院校相關系所畢業(**持國外學歷者，需符合教育部頒「大學辦理國外學歷採認辦法」之資格**)
3. 學、經歷及科系專長須符合員額需求表之學、經歷條件。
4. 報考人員學歷高於所報考之工作編號學歷需求，仍依員額需求表薪資範圍核薪。

(一)學歷認定以員額需求表所需學歷之畢業證書記載為準，如非理、工學院畢業者，其理工相關課程學分需超過總學分三分之二以上，同時論文題目需與理、工相關，且為本院研發任務所需之專長；前述理、工相關課程學分需超過總學分三分之二以上之規定，可檢具學校開立證明書認定，或由用人單位自行審查認定。

1. 其他限制：有下列情形之一者，不得進用；若於進用後本院始查知錄取人員有下列限制條件者，因自始即未符合報考資格，本院得取消錄取資格，並不得提出異議︰

(一)履歷內容填寫不實或於應徵過程中為虛偽意思表示及舞弊者。

(二)大陸地區人民、香港居民或澳門居民。

(三)無行為能力或限制行為能力者。

(四)曾因違反毒品危害防制條例案件，受觀察勒戒、強制戒治及刑之宣告者。

(五)犯內亂、外患、貪污罪及違反國家機密保護法，經判決有罪者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(六)曾犯前款以外之罪，經判處有期徒刑以上之刑，尚未執行或執行未完畢者。惟情節輕微且經宣告緩刑者，不在此限。

(七)因案被通緝或在羈押、管收中。

(八)依法停止任用者。

(九)褫奪公權尚未復權者。

(十)受監護宣告尚未撤銷者。

(十一)於本院服務期間，因有損本院行為，遭解僱或以不勝任人員資遣者。

(十二)本院各級主管之配偶及三親等以內血親、姻親，在其主管單位中應迴避任用。

(十三)因品德、操守或違反資安規定遭任職單位核予大過(含)以上之處分者。

**肆、報名時間及方式：**

1. 甄試簡章公告日期至**109年10月31日止，如招考員額提前額滿，即停止公告**。
2. 符合報考資格者，需至本院網路徵才系統(https://join.ncsist.org.tw) 填寫個人資料**(聯絡電話請填寫手機號碼)**及上傳**中科院之履歷表**(貼妥照片，格式如附件2)、學歷、經歷、成績單、英文檢定證明、論文、期刊發表、證照、證書、**勞保投保明細**等相關資料後，選擇報考職缺並投遞履歷。
3. 本所擇優篩選並完成資格審查後，以電子郵件或簡訊通知參加甄試，未獲選取者不另行通知。
4. 不接受紙本報名及現場報名。
5. 為提供本院聘雇員工職類轉換管道，本次招考開放院內符合報考資格之員工，可報名參加甄試。本院員工報名甄試者，不可報考同一職類，且需經單位一級主管同意後(報名申請表如附件3)，於本院網路徵才系統完成報名。另當事人需填具工作經歷(非職稱)後，由該工作經歷任職單位二級主管核章，無需檢附勞保明細表。
6. 應屆畢業生報名甄試時尚未取得畢業證書者，僅需繳交學生證掃描檔查驗。前述人員錄取後，需於本院寄發錄取通知日起至報到日期間，繳驗畢業證書正本(如為學校因素無法如期繳交，須出具學校開立之佐證證明)，若無法繳驗，則取消錄取資格。
7. 歡迎具身心障礙身分或原住民身分且符合報考資格者報名參加甄試，請於人才資料庫登錄資料時及履歷表上註記。

**伍、報名應檢附資料：報名資料未繳交齊全或資料內容無法辨識者，視同資格不符。各項資料務必依序彙整於同一檔案(PDF檔)上傳至本院網路徵才系統，並請自行調整資料版面之呈現方向(轉正)，以利閱讀，PDF檔名請設定：「考生姓名\_履歷」。**

1. 履歷表：**請依照附件2格式填寫，**並依誠信原則，確實填寫於本院服務之親屬及朋友關係，若未誠實填寫而錄取，經查屬實者，本院得予不經預告終止契約解除聘雇。
2. 符合報考學歷之畢業證書掃描檔。
3. 報考所需之個人相關掃描檔資料(如：**中科院之履歷表、**符合報考學歷畢業證書、工作經歷證明、證照、成績單或英文檢定成績等)，請參考簡章之員額需求表。需檢附英文能力相關證明(如附件4)：全民英檢中級/多益成績550分(含)以上及其他英文檢定證照同等級以上之證明書，未檢附視同資格不符。
4. 提供工作經歷證明者，格式不限，但需由任職機構(單位)或雇主蓋章認可，內容需註明從事之工作內容或職稱及任職時間。
5. 若有繳交民營機構之工作經歷證明，需再檢附**歷年勞保異動明細表**(如：勞保、公保、農保…等)，如未檢附，該工作經歷不予認可。(「勞保投保明細表」可利用「自然人憑證」至勞保局網站「勞工保險異動查詢」下載，需內含(曾)任職公司投保薪資、投保生效與退保日期)。
6. 具身心障礙身分者，檢附身心障礙手冊(證明)正、反面掃描檔。
7. 具原住民族身分者，檢附戶口名簿或戶籍謄本掃描檔，並標記族別。
8. 各項上傳資料之正本於錄取後報到時統一辦理繳驗，凡有偽造證件不實者，一律註銷錄取資格。

**陸、甄試時間、地點及方式：**

1. 甄試日期：**暫定每月辦理甄試作業，其甄試時間得依實際狀況彈性調整之，如招考員額提前額滿，即停止公告**(實際甄試時間以甄試通知為準)。
2. 甄試地點：暫定於本院新新院區(桃園市龍潭區)(實際甄試地點以甄試通知為準)。
3. 甄試方式：甄試科目及配分請參閱員額需求表
4. 初試：書面審查/口試初試。
5. 口試複試。
6. 甄試當日如遇天災、事變及突發事件(如：颱風來襲)等不可抗力之原因，本所得視情況合理之調整甄試作業時間、地點及甄試方式並應即通知應考人員。
7. 各項甄試作業(如：時間、地點…等)均以電子郵件或簡訊通知應考人員。請考生務必留意報考時提供之電子郵件帳號及手機號碼。若以電子郵件或簡訊通知無法聯繫到考生，視為該考生放棄報考，不再另行通知。
8. 口試甄試時，若考生未於規定時間內完成報到手續，需主動以電話先行告知，報到時間得視情況順延(1小時內為原則)。

**柒、錄取標準：**

1. 甄試合格標準：
2. 初試單項(書面審查/口試)成績合格標準請參閱員額需求表，未達合格標準者不予錄取。
3. 複試口試合格標準為70分(滿分100分)
4. 初、複試總成績合格標準為70分(滿分100分)。
5. 如有其中一項甄試項目缺考者，不予計算總分，且不予錄取。
6. 成績排序：

(一)以總成績高低依序錄取，總成績為口試複試平均成績。

(二)總成績相同時：

依序以初試總成績、口試平均成績、書面審查平均較高者為優先；遇所有成績均相同時，由本所決定錄取順序。

1. 儲備期限：

(一)完成各階段甄試後合格但未錄取之應徵者得設為備取人員， 並由單位依成績排定備取順序，依序備取，儲備期限自甄試結果奉本院督導副院長核定次日起4個月內有效。

(二)人員錄取或遞補來院報到後，其他於本院應徵職缺之錄取或遞補皆視同自動放棄。

**捌、錄取通知：**

1. 甄試結果於甄試後1個月內以電子郵件通知，各職缺錄取情形不予公告。
2. 人員進用：錄取人員試用3個月，試用期間經考核為不適任人員，予以資遣並核予資遣費。
3. 錄取人員若無特殊原因（需事先說明），未於約定時間內完成報到者視同放棄錄取資格，逕由備取人員依序辦理遞補作業。

**玖、如有任何問題歡迎電詢聯絡人員：**

電子信箱：mrsrd6503@ncsist.org.tw

總機：(03)471-2201或 (02)2673-9638

聯絡人及分機：邱來聲 副組長352268

沈陞豪 先 生352478

**請再次確認報名檢附資料是否齊全**

●**報名資料未繳交齊全或資料內容無法辨識者，視同資格不符。**

●**各項資料務必依序彙整於同一檔案(PDF檔)上傳至本院網路徵才系統。並請自行調整資料版面之呈現方向，以利閱讀，ＰＤＦ檔名格式：「考生姓名\_履歷」**

**□履歷表**

請依照附件2格式填寫，並依誠信原則，確實填寫於本院服務之親屬及朋友關係，若未誠實填寫而錄取，經查屬實者，本院得予不經預告終止契約解除聘雇。

**□畢業證書**

應屆畢業生報名甄試時尚未取得畢業證書者，需繳交學生證掃描檔查驗。

**□報考所需之個人相關資料**

如：符合報考學歷畢業證書、工作經歷證明、證照、成績單或英文檢定成績等，請參考簡章之員額需求表。英文檢定對照表如附件4。

**□工作經歷證明**

格式不限，但需由任職機構(單位)或雇主蓋章認可，內容需註明從事之工作內容或職稱及任職時間。

**□歷年勞保異動明細表**

需內含(曾)任職公司投保薪資、投保生效與退保日期，如未檢附，該工作經歷不予認可，無工作經驗者免提供。

**□具身心障礙身分者**，檢附身心障礙手冊(證明)正、反面掃描檔。

**□具原住民族身分者**，檢附戶口名簿或戶籍謄本掃描檔，並標記族別。

**□本院同仁**

需上傳經單位主管核章之招考報名申請表掃描檔(如附件3)。

**\*各項上傳資料之正本於錄取後報到時統一辦理繳驗，凡有偽造證件不實者，一律註銷錄取資格。**

附件1

| **國家中山科學研究院飛彈火箭研究所109年第三次人力進用招考員額需求表** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工作编號** | **職類** | **學歷需求** | **薪資**  **範圍** | **專長**  **(技能)** | **學歷、經歷條件** | **工作內容** | **需求**  **員額** | **工作地點** | **甄試**  **方式** |
| 1 | 研發類 | 博士 | 77,250│  85,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/航空/應用力學/造船/工程科學/動力機械/系統工程/核子工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學、研究所及博士各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具熱流相關研發工作經驗。  2.具流體力學/熱流學等相關領域之研究經驗。  3.具熱流試驗或分析軟體使用工作經驗。  4.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 至少從事下列工作之一：   1. 熱控制系統 2. 規劃、設計、分析。 3. 高溫熱防護設計、分析。 4. 熱傳試驗規劃、執行等工作。 5. 熱流數值模擬分析。 6. 熱流數值分析軟體開發。 | 2 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 2 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 機械/航空/造船/系統工程 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力/飛機/冷凍空調/工程科學等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具系統工程/專案管理/生產管理相關工作經驗。  2.具MS Office軟體(含Project)操作能力。  3.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 至少從事下列工作之一：  「系統工程」及「專案管理」的推動與執行。  1.飛彈、火箭及相關武器系統裝備之研發、生產和後勤之系統整合。  2.硬品產製與預算支用之規劃和管制。 | 5 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 3 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/航空等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具渦輪發動機/熱流/燃燒/氣動力/噴射推進等相關領域背景。  2.具熱流實驗/風洞實驗相關工作經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.渦輪發動機、飛行載具引擎地面試驗之規劃、執行、數據分析。  2.試驗/試驗設備相關之熱流問題分析、評估、研究。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 4 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/航空等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具機械設備設計/加工/製造及產品製程規劃等技術及工作經驗。  2.具結構與機構之動、靜態設計/分析或試驗背景及CAD/CAE軟體工作經驗。  3.具高壓氣體管線設計/分析/繪圖工作經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.設備結構、機構、關鍵組件及相關裝備設計、開發、分析或試驗相關工作。  2.高壓氣體管線之管路規劃、設計繪圖、分析與操作相關工作。 | 2 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 5 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 電子/電機/控制/資訊/航空/機械 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電子/電機/控制/資訊/航空/機械/計算機等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具LabVIEW軟體CLD進階認證(需檢附證明資料)。  2.具PC base LabVIEW程式2年(含)以上撰寫經驗。  3.具儀具整合，資料擷取及通訊協定撰寫工作經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.風洞試驗設備儀控模組設計操控。  2.風洞試驗設備擷取控制系統軟體開發及編撰。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 6 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/航空/造船/土木/應用力學/機電/系統科學/工程科學/營建/動力機械/車輛/系統工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具機械、造船之結構設計分析、結構試驗、模態測試及量測技術等相關研究或工作經驗。  2..熟悉SolidWorks、Pro/E、AutoCAD、Famos、Matlab、 LabView、ME’scope (或其他模態測試軟體)等軟體工具之一。  3..具結構有限元素分析相關研究工作經驗及結構分析套裝軟體使用實務經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.各型火箭飛彈及水下載具結構/機構/關鍵組件及相關裝備之研發設計/分析模擬/組測試驗。  2.載具結構系統工程之系統規劃/分析，介面協調/整合等。 | 4 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 7 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 控 制 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.航太/控制/造船/電機/動機/資訊/工程科學/機械/應力/測量等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.孰悉Matlab、Labview相關軟體。  2.具軟體開發或C/C++之相關工作經驗。  3.孰悉DSP即時軟體開發環境。  4.孰悉控制系統設計。  5.具導航系統設計實務經驗。 | 至少從事下列工作之一：   1. 控制系統之設計/測試/分析。 2. 導航系統之設計/測試/分析。 | 2 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 8 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 電子/電機/機械/資訊 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電子/電機/機械/資訊等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.孰悉Matlab、Labview相關軟體。  2具軟體開發或C/C++之相關工作經驗。  3.孰悉FPGA、ARM、DSP設計經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.撰寫FPGA、MCU等相關周邊韌體研發，包括設計、測試、分析等。  2.類比及數位濾波器研製，包括設計、測試、分析等。  3.系統工程，包括系統規劃、分析，介面協調、整合等。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 9 | 研發類 | 碩士 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電子/電機/控制/電信/光電/資訊工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單(未檢附者，視同資格不符)，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具類比、數位電路、單晶片設計經驗。  2.具下列軟體開發經驗C++/Linux/Matlab /LabVIEW/內嵌式程式。  3.具通訊與數位信號處理經驗。  4.具FPGA/ASIC設計經驗。  5.具RF電路設計及調校經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.慣性及衛星接收機導航系統軟硬體開發。  2.DSP/ARM處理器軟體/韌體/硬體開發研製。  3.FPGA VHDL，VERILOG等相關語法工具，進行數位電路縮裝開發設計。  4.高頻訊號量測及調教。 | 2 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 10 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 電子/電機/資訊 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電子/電機/資訊等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具電子/資訊相關研發或生產工作經驗。  2.具類比、數位電路設計經驗。  3.具下列開發經驗之  一：C/C++ /Matlab /LabVIEW。  4.具FPGA或DSP設計經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.光纖陀螺儀系統之研發，包括設計、測試、分析等。  2.測試工程，包括測試環境建置，自動化測試，介面協調、軟硬體整合等。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 11 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/應用力學/動力等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具機電設備/模組機構設計、工程分析、製程規劃相關工作經驗。  2.具SolidWorks、AutoCAD等CAD/CAM軟體工作經驗。  3.具振動分析/試驗相關工作經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.導航機電模組的研發，包括機構設計、繪圖、工程分析、製程規劃等。  2.導航機電模組抗振動性能的設計、測試與分析。  3.設計檢測用夾治具。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 12 | 研發類 | 碩士 | 56,650  |  65,000 | 控制 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.航太/機械/電機/電控/應用力學/工程科學/土木/船舶/數學/物理等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)**：  1.具控制系統分析、設計或模擬修習或工作經 驗。  2.具應用力學及流體力學修習或工作經驗。  3.具導引律設計/分析或模擬修習或工作經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.飛行控制系統(自動駕駛儀)設計。  2.6-DOF Simulation (六自由度模擬)。 | 2 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 13 | 研發類 | 碩士 | 56,650  |  65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/應用力學/航太/造船/動力/系統工程/機電/土木等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具Pro/E、Solidworks等3D CAD軟體或機械設計能力。  2.具有限元素分析軟體使用經驗。  3.具機構分析軟體使用經驗。  4.具液/氣壓系統設計經驗。  5.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 執行機械零組件、機構系統及液/氣壓系統的研發設計、分析模擬、製造、組裝、測試驗證等工作。 | 4 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 14 | 研發類 | 碩士 | 56,650  |  65,000 | 電子/電機/資工 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電子/電機/機械/控制/電信/光電/資訊工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.熟悉C/C++程式語言。  2.具Visual Studio、MFC、Qt、CAN bus、LabWindows/CVI等開發經驗尤佳。  3.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.整合電子、馬達或液壓控制、通信之人機介面或操控軟體開發，主要作業平台包含Windows及Linux。  2.內嵌式系統之韌體開發，主要的CPU包含8086、8051、ARM等。  3.PXI測試系統之控制程式開發撰寫。 | 2 | 桃園  龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 15 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 資訊/電子/電機 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.資訊/電子/電機/控制/電信/光電工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具微處理器、DSP、FPGA等嵌入式系統軟體開發工作經驗。  2.具C/C++/Java電腦程式語言撰寫能力及工作經驗。  3.具linux系統及Qt IDE跨平台程式開發工作經驗。  4.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或上課證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.導航、導控、飛控或射控應用法則於嵌入式系統軟體研發。  2.應用微軟視窗或linux等作業系統上之人機介面程式開發。  3.系統核心設計與測試，開源即時作業系統導入及應用軟體研發。  4.系統分析模擬，測試系統整合設計。  (需配合加班及出差) | 3 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 16 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 資訊/電子/電機 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.資訊/電子/電機/控制/電信/光電工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具微處理器、DSP、FPGA等嵌入式系統硬體開發工作經驗。  2.具C/C++/Java電腦語言能力，撰寫中層驅動界面程式工作經驗。  3.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或上課證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.微處理器(微控制器)為基礎之數位電路設計、測試與驗證。  2.處理器內核之晶片系統(SOC) 之數位電路設計、測試與驗證。  3.通訊介面硬體之設計、測試與驗證，或及驅動韌體。  4.閘陣列數位介面(FPGA) 之設計、測試與驗證。  5.類比介面之設計、測試與驗證。  (需配合加班及出差) | 3 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 17 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/控制/航空/造船/應用力學/機電/系統科學/工程科學等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.熟悉機械設計3D CAD軟體（NX、Pro/E、SolidWorks等）。  2.熟悉Matlab、LabVIEW、單晶片控制技術及C/C++語言。 | 至少從事下列工作之一：  1.伺服致動器機構與控制系統設計/分析/模擬/組裝與測試。  2.系統工程，包括系統規劃、分析，介面協調、整合等。  3.產品設計、元件規格訂定、物料採購等。  4.單晶片韌體開發與人機械界面設計。  5.生產文件整備與流程控管。  (需配合加班及出差) | 3 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 18 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 電子/電機 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電子/電機/電信/控制/資訊工程/通訊等理工系所畢業。  2.具C/C++語言或LabVIEW開發經驗或認證(請檢附證明資料)。  3.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  4.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具電子/電機/電信/控制/資訊工程/通訊工程相關工作經驗。  2.具嵌入式系統設計/實現/應用相關工作經驗。  3.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.測試器軟硬體開發設計/嵌入式系統應用開發。  2. PXI模組化測試系統研發設計及整合。  3.測試器故障診斷與排除。 | 4 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 19 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 電子/電機 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電子/電機等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具電力系統開發工作經驗。  2.具電力電子電路設計及DSP韌體撰寫等相關工作經驗。  3.具能源管理控制器軟韌體開發/儲電系統整合設計/電池模組研製等相關工作經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.電力能源管理控制器開發。  2.電力電子系統韌體及硬體開發。  3.儲電系統整合開發及應用。  4.電池模組研製與測試。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 20 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/電機/車輛/航空/造船/自動控制/系統/兵器/物理/土木等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具大型機械/機構/車輛/車廂研究設計製造經驗。  2.具電腦/網路/自動控制/CAD/CAM/CAE/電匠/室內配線等相關證照。  3.具吊裝/搬運/高空作業/大貨車/特種車輛等相關證照。  4.參加國內外機械/機電相關項目競賽獲獎。 | 至少從事下列工作之一：  1.大型機械/機構/電子車廂設計開發。  2.輕量化金屬機械/機構/元件設計開發。  3.電力自動控制系統/人機介面整合設計開發。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 21 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 鍛造 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/航空等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具鍛造相關研發工作經驗。  2.具鍛件模流模擬Simufact Forming、QForm 3D、Deform 3D軟體經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.鍛造相關設備規畫與籌建。  2.鍛造工程，包括製程規劃、模具設計，鍛造模流分析等。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 22 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具機械設計/加工/製造及產品製程規劃等技術及工作經驗。  2.具CAD/CAM製程設計工作經驗。  3.熟悉機械設計Solid Works繪圖軟體。  4.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 機械設計/製造及產品製程規劃/研發/產能籌建/測試分析/生產規劃與專案管理等產製。 | 3 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 23 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/車輛/航太/造船/輪機/模具/製造/機電/自動控制/應用力學/動力等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具機械設計/加工/製造及產品製程規劃/CAD/CAM製程設計等技術及工作經驗。  2.具機械設備開發/液壓設備或組件測試設備開發及測試程式設計規劃撰寫等相關工作經驗1年(含)以上。  3.熟悉機械設計Solid Works繪圖軟體。  4.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 至少從事下列工作之一：  1.機械設計/製造及產品製程規劃/研發/產能籌建/測試分析等產製工作。  2.精密液壓組件、超低溫致冷器研發，含籌料、零件製造/組件組裝/總成測試等技術開發。 | 4 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 24 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 電子/電機 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電子/電機/控制/電信/光電/資訊/通訊/動力機械/電控/應用力學/航太/機械/物理/應用物理/車輛工程/自動化科技/工程科學等理工系所畢業或其他理工系所之電子/電機/控制相關組別畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具Keil C語言開發能力或工作經驗。  2.具微處理器/DSP、FPGA等嵌入式系統開發工作能力或工作經驗。  3.具類比/數位電路/單晶片設計整合經驗。  4.具電子電路整合設計/電力電子系統整合設計能力或工作經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.航太模組控制軟體/韌體開發。  2.軟體/韌體、DSP數位電路及微處理器軟硬體開發研製。  3.系統核心設計與測試/系統分析模擬。  4.電力電子系統設計與開發。  5.類比及數位控制電路設計/分析與驗測。 | 2 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 25 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/航空/飛機/車輛/造船/輪機/動力機械/應用力學/機電/製造/系統科學/工程科學/系統工程等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具機械結構/機構設計相關工作經驗1年(含)以上。  2.熟悉下列軟體之一: SolidWorks、Pro/E、AutoCAD。 | 各型武器系統之總成及關鍵零組件之機械/結構/機構設計開發及系統工程相關。 | 3 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 26 | 研發類 | 碩士 | 56,650│ 65,000 | 電機/控制 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電機/電子/光電/控制等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具控制系統分析/設計工作經驗。  2.具電路圖規畫及電路製作工作經驗。  3.熟悉C/C++、MatLab或LabVIEW等程式語言。  4.具使用控制器經驗，如：PLC/工業電腦/單晶片/伺服驅動器…等。 | 各式武器系統之電控系統設計/機電整合及其軟硬體之實現與組測。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 27 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 電機/機械/資工 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電機/機械/資工等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具機電整合/控制系統模擬/測試驗證等工作經驗。  2.熟悉程式語言Matlab/Simulink/C。 | 至少從事下列工作之一：  1.外骨骼機電系統整合及測試驗證，工作包括外骨骼動態系統模擬、測試驗證規劃、控制器參數調教、測試數據分析等。  2.系統工程，包括系統需求確認、規格擬定、軟硬體模擬分析，介面整合、分系統溝通協調、測試驗證等。 | 1 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 28 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 機械/航空 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.機械/航空等理工系所畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.具推進相關研發工作經驗。 | 至少從事下列工作之一：  1.各型火箭發動機之研發，包括設計、測試、分析等工作。  2.系統工程，包括系統規劃、分析，介面協調、整合等工作。 | 3 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 29 | 研發類 | 碩士 | 56,650│  65,000 | 電子/電機/資工 | **＊投遞履歷前請詳閱招考簡章。**  **＊請檢附歷年勞保異動明細表，無工作經驗者免提供。**  **＊需具下列條件(未檢附證明資料，視同資格不符)：**  1.電子/電機/控制/電信/光電/資訊工程等理工系所畢業或機械系所控制組畢業。  2.需檢附大學及研究所各學年成績單，與有助審查資料(相關專業經驗、專題、論文)。  3.具有全民英檢中級或TOEIC 550以上及其它英文檢定證照同等級以上(需檢附證明資料)。  **＊具下列條件為佳(請檢附證明資料)：**  1.熟悉AUTOCAD或PRO E繪圖軟體，電路分析及電路設計。  2.其他可資佐證符合專長(技能)或工作內容需求之公、民營機構訓練證照或證明。 | 系統電力、電路設計及繪製、電控零件選用及系統安裝及維護。 | 2 | 桃園龍潭 | **初試：**  **1.書面審查**  **40%**  (70分合格)  **2.口試60%**  (70分合格)  **複試：**  **口試100%**  (70分合格) |
| 合計：研發類65員。 | | | | | | | | | |

附件2

**履　　　　　歷　　　　　表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ★姓名 |  | 英文姓名  (與護照相同) | |  | | ★身分證  號碼 | | | | |  | | | | 最近三個月  1吋半身脫帽照片 |
| 出生地 |  | ★出生日期 | | 年月日 | | 婚姻 | | | | | □已婚 □未婚 | | | |
| ★兵役狀況 | | □役畢□免役□未役□服役中(退役時間：　　　　　) | | | | | | | | | | | | |
| ★電子郵件 | |  | | | | | | | | | | | | |
| ★通訊處 | 戶籍  地址 |  | | | | | | | | | | 行動電話 | | |  |
| 通訊  地址 |  | | | | | | | | | | 連絡電話 | | |  |
| 居住國外在台聯絡人員  (緊急聯絡人) | |  | | 行動電話 | |  | | | | | 連絡電話 | | |  |
| ★  學歷 | 學校名稱 | | | | 院系科別 | | | | 學位 | | | 起迄時間 | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
|  | | | |  | | | |  | | |  | | | |
| 註：學歷欄按所獲學位，由高至低順序填寫(例：按博士－＞碩士－＞學士順序)。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| ★  經歷 | 服務機關名稱 | | | | 職稱(工作內容) | | | | | | | | 起迄時間 | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | |  | | |
| 家庭狀況  ★ | 稱謂 | 姓名 | | | 職業 | | | | | 服務機關 | | | 連絡(行動)電話 | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
|  |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| **□是 有在中科院任職之親屬及朋友者請填寫以下欄位 □否 以下欄位不需填寫** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 三親等親屬及朋友  在中科院任職之  ★ | 關係(稱謂) | | 姓名 | | | | | 單位 | | | | | | 職稱 | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
|  | |  | | | | |  | | | | | |  | |
| 身體 | 身高：　　　　　　　公分 | | | | 體重：　　 　　　公斤 | | | | | | | | 血型： 　　　型 | | |
| 其他 | 原住民 | □山地 □平地 | | | | | | | | 族 別：　　　 　　　　　族 | | | | | |
| 身心  障礙 | 殘障等級：　　　　　　　　　度 | | | | | | | | 殘障類別：　　　　　　　　　障(類) | | | | | |

備註：有★為必填欄位

|  |
| --- |
| 自述(本表若不敷使用請自行延伸) |
|  |

　　　　　　　　　　填表人：　　　 　　　（簽章）

(提醒：請依本履歷規定格式撰寫(含履歷表、自傳及報考項次之學歷、經歷條件需求資料)，視需要可自行增加，整份履歷表必須彙整為一個PDF檔案上載)

**依報考工作編號學歷、經歷條件需求資料，依序自行增修，如未檢附者，視同資格不符**

1. 畢業證書(符合報考職缺學歷要求之畢業證書及最高學歷畢業證書)

(請貼上畢業證書圖檔)

1. 學歷文件(大學成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上大學成績單圖檔)

1. 學歷文件(碩、博士成績單) (本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上碩、博士成績單圖檔)

1. 英文測驗證明文件(本項視報考工作之編號學歷、經歷條件需求，如全民英檢、多益、托福…等)

(請貼上英文證明文件圖檔)

1. 具各公營機構相關技能訓練證照或證明(請檢附訓練時數300小時以上相關證明)或其它相關證照(本項視學歷、經歷條件需求)

(請貼上證照正反面圖檔)

1. 相關專業工作經歷證明(本項視學歷、經歷條件需求，本項需公司開出之證明文件)

(請貼上工作經歷證明圖檔)

1. 其它補充資料或特殊需求(本項視學歷、經歷條件需求，或補充自身相關專業之專題、論文、獲獎文件…等資料)

**履歷表補充附表**

**填表日期： 年 月 日有 ★為必填欄位**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | ★**姓名** | | |  | | | | | | | |
| **2** | ★**報考職類** | | | □研發類　 □技術類　 □行政、管理類 | | | | | | | |
| **3** | ★**報考項次** | | |  | | | | | | | |
| **4** | ★**前一份工作月薪** | | | 元 | | | ★**前一份工作年薪** | | | 元 | |
| **5** | ★**預期月薪** | | | 元 | | | ★**可接受最低月** | | | 元 | |
| **6** | **語言能力** | | |  | | | | | | | |
| **7** | **專長** | | |  | | | | | | | |
| **8** | **本院產學合作案或其他合作計畫** | | | | | | | | | | |
| 8.1 | 計畫名稱 |  | | | 期程 | 至 | | 本院合作單位 | | |  |
| **9** | **證照** | | | | | | | | | | **計\_\_\_\_張** |
| **10** | **論著** | | | | | | | | | | |
| **10.1** | **碩士論文名稱** | |  | | | | | | | | |
| **10.2** | **博士論文名稱** | |  | | | | | | | | |
| **10.3** | **國內外學術期刊發表論文** | | | | | | | | **計\_\_\_\_\_篇** | | |
| 10.3.1 | 論文名稱 | |  | | | | | | | | |
| 發表期刊名稱 | |  | | | | | | | | |
| **10.4** | **國內外研討會發表論文** | | | | | | | | **計\_\_\_\_\_篇** | | |
| 10.4.1 | 論文名稱 | |  | | | | | | | | |
| 研討會名稱 | |  | | | | | | | | |
| **10.5** | **其他著作** | | | | | | | | **計\_\_\_\_\_篇** | | |
| 10.5.1 | 著作名稱 | |  | | | | | | | | |

(本表若不敷使用請自行延伸) 備註：有★為必填欄位

附件3

**國家中山科學研究院**

**各類聘雇員工參加招考報名申請表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 現職單位  （至二級） | | 姓名  (身分證號碼) | 職類及級職 | 最高學歷  (含科/系/所) | |
|  | |  |  |  | |
| 擬參加甄選單位職缺 | | | | | |
| 報考單位(或工作編號) | | | 職類 | | 職缺 |
|  | | |  | |  |
| 本人簽章 | 二級單位 | | 一級單位主管批示 | | |
| 電話： |  | |  | | |
| 一級人事單位 | |
|  | |

備註：非本院現職員工免填。

附件4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 同等語文能力測驗標準表 | | | | |
| 全民英檢 | 多益(TOEIC) | 托福  (TOFEL iTP) | 托福  (TOFEL iBT) | 雅司  (IELTS) |
| 優級 | 950(含)以上 | 630(含)以上 | - | 7.5(含)以上 |
| 高級 | 880(含)以上 | 560(含)以上 | 95(含)以上 | 6.5(含)以上 |
| 高/中級 | 750(含)以上 | 527(含)以上 | 72(含)以上 | 5.5(含)以上 |
| 中級 | 550(含)以上 | 457(含)以上 | 42(含)以上 | 4(含)以上 |

附件5

中山科學研究院徵才系統履歷投遞說明

1.請先至中科院官網：(<http://www.ncsist.org.tw/csistdup/main/Default.aspx>)點擊「菁英招募」查看最新招募簡章。

2.欲投遞履歷時請直接點選:點我投遞履歷。

3.欲知詳細說明請點閱:投遞說明。

